

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09283794 A

(43) Date of publication of application: 31 . 10 . 97

(51) Int. CI

H01L 33/00

B41J 2/44

B41J 2/45

B41J 2/455

H01L 29/74

(21) Application number: 08085236

(22) Date of filing: 08 . 04 . 96

(71) Applicant:

NIPPON SHEET GLASS CO LTD

(72) Inventor:

KUSUDA YUKIHISA OTSUKA SHUNSUKE

ONO SEIJI

(54) SURFACE LIGHT-EMITTING ELEMENT AND SELF-SCANNING TYPE LIGHT-EMITTING DEVICE

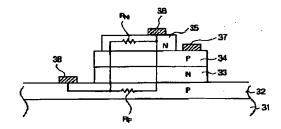
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve a surface light-emitting diode and further to heighten external light-emitting efficiency by making a sheet resistance value of a second semiconductor layer less than a sheet resistance value of a first semiconductor layer.

SOLUTION: A P-type semiconductor layer 32, an N-type semiconductor layer 33, a P-type semiconductor layer 34 and an N-type semiconductor layer 35 consisting of GaAs are by turns laminated on an insulating GaAs substrate. A cathode electrode 36 is provided on the N-type layer 35, a gate electrode 37 is provided on the P-type layer 34 and an anode electrode 38 is provided on the P-type layer 32. In consideration of a sheet resistance circuit from directly under the cathode electrode 36 to the anode electrode 38 and regarding that a sheet resistance value of the N-type layer 35 is R_n and that a sheet resistance value of the P-layer 32 is Rp, the sheet resistance values R_n, R_p are defined by the sizes and the impurity concentration of the N-type semiconductor layer 35 and the P-type semiconductor layer 32. Accordingly, the sheet resistance value $\rm R_{\rm n}$ is made smaller than the sheet resistance vale Rp and a current is concentrated to an end so as to raise an external

light-emitting efficiency.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-283794

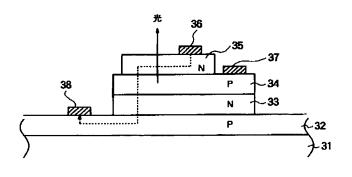
(43)公開日 平成9年(1997)10月31日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所		
H01L	33/00			H01L 3	3/00	Α		
B41J	2/44			B 4 1 J 3/21		L		
	2/45			H01L 2	9/74	E		
	2/455							
H01L	29/74							
				審査請求	未請求	請求項の数8	OL	(全 13 頁)
(21)出願番号		特願平8-85236		(71)出願人	000004008			
					日本板	硝子株式会社		
(22)出顧日		平成8年(1996)4		大阪府:	大阪市中央区道	多町3二	厂目5番11号	
			(72)発明者 楠田		幸久			
					大阪府	大阪市中央区道(多町37	丁目5番11号
					日本	板硝子株式会社区	4	
				(72)発明者				
						大阪市中央区道館		厂目5番11号
					• - •	板硝子株式会社区	4	
				(72)発明者				
						大阪市中央区道信		厂目5番11号
						板硝子株式会社P	4	
				(74)代理人	弁理士	岩佐義幸		

(54) 【発明の名称】 面発光素子および自己走査型発光装置

(57)【要約】

【課題】 外部発光効率の良い面発光素子を提供する。 【解決手段】 絶縁基板31上に設けられたP形の半導体層32と、半導体層32上にメサ構造により設けられた、N形の半導体層33、P形の半導体層34と、N形の半導体層35と、半導体層32上に設けられたアノード電極38と、半導体層34上に設けられたゲート電極37と、半導体層35上に設けられたカソード電極36とを備え、N形半導体層35のシート抵抗値を、P形半導体層32のシート抵抗値以下とした。



20

【特許請求の範囲】

【請求項1】絶縁基板上に設けられた第1導電形の第1の半導体層と、第1の半導体層上にメサ構造により設けられた第2導電形の第2の半導体層と、第1の半導体層上に設けられた第1の電極と、第2の半導体層上に設けられた第2の電極とを備える面発光ダイオードにおいて、

第2の半導体層のシート抵抗値を、第1の半導体層のシート抵抗値以下としたことを特徴とする面発光ダイオード。

【請求項2】第1導電形はP形であり、第2導電形はN 形である、請求項1記載の面発光ダイオード。

【請求項3】絶縁基板上に設けられた第1導電形の第1の半導体層と、第1の半導体層上にメサ構造により設けられた、第2導電形の第2の半導体層、第1導電形の第3の半導体層、第2導電形の第4の半導体層と、第1の半導体層上に設けられた第1の電極と、第3の半導体層上に設けられた第2の電極と、第4の半導体層上に設けられた第3の電極とを備える面発光サイリスタにおいて

第4の半導体層のシート抵抗値を、第1の半導体層のシート抵抗値以下としたことを特徴とする面発光サイリスタ。

【請求項4】第1導電形はP形であり、第2導電形はN 形である、請求項3記載の面発光サイリスタ。

【請求項5】スイッチング動作のためのしきい電圧またはしきい電流の制御電極を有するスイッチ素子を複数個配列し、各スイッチ素子の前記制御電極をその近傍に位置する少なくとも1つのスイッチ素子の制御電極に、接続用抵抗または電気的に一方向性を有する電気素子を介して接続するとともに、各スイッチ素子の制御電極に電源ラインを負荷抵抗を介して接続し、かつ各スイッチ素子にクロックパルスラインを接続して形成したスイッチ素子アレイと、

発光動作のためのしきい電圧またはしきい電流の制御電極を有する発光素子を複数個配列した発光素子アレイとからなり、

前記発光素子アレイの各制御電極を前記スイッチ素子の 制御電極と電気的手段にて接続し、各発光素子に発光の ための電流を供給する配線を設けた自己走査型発光装置 において、

前記発光素子およびスイッチ素子は、それぞれ、請求項 3または4記載の面発光サイリスタよりなることを特徴 とする自己走査型発光装置。

【請求項6】前記スイッチ素子アレイと前記発光素子アレイとは、略平行に、かつ略直線状に配列され、

前記各スイッチ素子の第1の電極および前記各発光素子の第1の電極は、前記スイッチ素子アレイと前記発光素子アレイとの間に設けられた共通の1本の接地配線よりなる、請求項5記載の自己走査型発光装置。

2

【請求項7】前記電流供給配線に接続される第1のボンディングパッドと、前記接地配線に接続される第2のボンディングパッドとを備え、前記第1および第2のボンディングパッドは、前記発光素子アレイの配列方向両端に設けられている、請求項6記載の自己走査型発光装置。

【請求項8】発光動作のためのしきい電圧またはしきい電流の制御電極を有する発光素子を複数個配列し、各発光素子の前記制御電極をその近傍に位置する少なくとも1つの発光素子の制御電極に、接続用抵抗または電気的に一方向性を有する電気素子を介して接続するとともに、各発光素子に電源ラインを負荷抵抗を介して前記制御電極に接続し、かつ各発光素子にクロックラインを接続して形成した自己走査型発光装置において、

前記発光素子は、請求項3または4記載の面発光サイリスタよりなることを特徴とする自己走査型発光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、面発光ダイオード, 面発光サイリスタのような面発光素子の外部発光効率を高めるための構造、およびこのような面発光素子を用いた自己走査型発光装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、面発光素子の代表的なものとして発光ダイオードおよびレーザダイオードが知られている。発光ダイオードは化合物半導体(GaAs, GaP, AlGaAs等)のPN接合またはPIN接合を形成し、これに順方向電圧を加えることにより接合内部にキャリアを注入し、その再結合の過程で生じる発光現象を利用するものである。

【0003】またレーザダイオードは、この発光ダイオードの内部に導波路を設けた構造となっている。あるしきい電流以上の電流を流すと注入される電子ー正孔対が増加し反転分布状態となり、誘導放射による光子の増倍(利得)が発生し、へき開面などを利用した平行な反射鏡により発生した光が再び活性層に帰還されてレーザ発振が起こる。そして導波路の端面からレーザ光が出射されていくものである。

【0004】これら発光ダイオード、レーザダイオードと同じ発光メカニズムを有する発光素子として、発光機能を有する負性抵抗素子(発光サイリスタ、レーザサイリスタ等)も知られている。発光サイリスタは先に述べたような化合物半導体でPNPN構造を作るものであり、シリコンではサイリスタとして実用化されている。これらについては、例えば青木昌治編著「発光ダイオード」工業調査会、167~169頁に記載されている。この発光機能を有する負性抵抗素子(ここでは発光サイリスタと呼ぶ)の基本構造は、N形GaAs基板上にPNPN構造を形成したもので、サイリスタと全く同じ構造である。電流一電圧特性もサイリスタと全く同じS字

3

形負性抵抗の特性を示す。

【0005】また本出願人は、面発光型のサイリスタ (以下、面発光サイリスタという) を用いた自己走査型 発光装置について、既に多くの出願において開示してい る。例えば、特開平2-263668号公報「発光装 置」、特開平2-212170号公報「発光素子アレイ およびその駆動方法」、特開平3-55885号公報 「発光・受光モジュール」、特開平3-200364号 公報「光信号の読み取り方法及びこれに使用するスイッ チ素子アレイ」、特開平4-23367号公報「発光装 置」、特開平4-296579号公報「発光素子アレイ の駆動方法」である。

【0006】多数個の発光素子を同一基板上に集積した 発光素子アレイはその駆動用 I Cと組み合わせて光プリ ンタ等の書き込み用光源として利用されている。本発明 者らは発光素子アレイの構成要素としてPNPN構造を 持つ面発光サイリスタに注目し、発光点の自己走査が実 現できることを既に特許出願し、光プリンタ用光源とし て実装上簡便となること、発光素子ピッチを細かくでき ること、コンパクトな自己走査型発光装置を作製できる こと等を示した。

【0007】さらに本発明者らは、スイッチ素子アレイ をシフトレジスタとして、発光素子アレイと分離した構 造の自己走査型発光装置を提案している(特開平2-2 63668号公報)。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】面発光ダイオード、面 発光サイリスタのような面発光素子においては、電流を 注入する電極の真下に発光中心が位置し、電極自身が遮 光層となって外部発光効率が良くないという問題があ る。この問題を面発光サイリスタを例に説明する。

【0009】図1 (a), (b) は、メサ型のPNPN 構造の従来の面発光サイリスタの断面図および平面図を 示す。この面発光サイリスタは、N形半導体基板1上に 形成されたN形半導体層 2 4, P形半導体層 2 3, N形 半導体層22, P形半導体層21と、P形半導体層21 にオーミック接触するように形成されたアノード電極4 0とを備えている。図1 (a) の構造上には、図示しな いが全体に絶縁被膜(光を透過する絶縁材料よりなる) が設けられ、その上にA1配線140が設けられてい る。絶縁被膜には、電極40とA1配線140とを電気 的に接続するためのコンタクトホールCが開けられてい る。また、N形半導体基板1の裏面には、カソード電極 (図示せず) が設けられている。

【0010】このようなPNPN構造の面発光サイリス タにおいては、アノード電極40から流れる電流は、図 1 (a) に矢印で示すように、電極40の真下に向かっ て主に流れる。したがってゲート層22,23での発光 中心は電極40の真下にある。このように発光中心が電 極40の真下にあるため、光が電極40自身さらにはA

1配線140によって遮られる結果、外部発光効率が良 くない。

【0011】また電極40に近い所では、注入電流が大 きいため発光光量は大きいが、電極40から遠ざかるに 従って、注入電流が小さくなるため発光光量は小さくな る。これは、外部発光効率を低下させる要因の1つとも なっている。

【0012】一方、特開平6-140666号公報「モ ノリシック発光ダイオードアレイ」には、外部量子効率 の高い、すなわち外部発光効率の良い面発光ダイオード が提案されている。これによると、図2に示すように、 絶縁形GaAs基板10上にP形AIGaAs活性層1 1およびN形AIGaAsクラッド層12が設けられ、 クラッド層12上にカソード電極(個別コンタクト電 極) 13が、活性層11上にアノード電極(共通コンタ クト電極) 14が設けられている。

【0013】アノード電極14が活性層11上に設けら れているため、カソード電極13から注入された電子 は、点線矢印で示すようにアノード電極14に向って流 れる。したがって、発光中心がカソード電極13の真下 からずれる結果、カソード電極13に妨げられることな く光を取り出すことができる。

【0014】しかし、この従来技術は、活性層の表面に 共通コンタクト電極を設けるという基本思想を開示する のみであって、外部発光効率を高めるという点について は、なんら示唆するところがない。

【0015】この発明の目的は、上記面発光ダイオード を改良し、さらに外部発光効率を高めることにある。

【0016】この発明の他の目的は、外部発光効率を高 30 めた面発光サイリスタを提供することにある。

【0017】この発明のさらに他の目的は、上記面発光 サイリスタを用いた自己走査型発光装置を提供すること にある。

[0018]

40

【課題を解決するための手段】本発明は、絶縁基板上に 設けられた第1導電形の第1の半導体層と、第1の半導 体層上にメサ構造により設けられた第2導電形の第2の 半導体層と、第1の半導体層上に設けられた第1の電極 と、第2の半導体層上に設けられた第2の電極とを備え る面発光ダイオードにおいて、第2の半導体層のシート 抵抗値を、第1の半導体層のシート抵抗値以下としたこ とを特徴とする。

【0019】また本発明は、絶縁基板上に設けられた第 1 導電形の第1の半導体層と、第1の半導体層上にメサ 構造により設けられた、第2導電形の第2の半導体層、 第1導電形の第3の半導体層と、第2導電形の第4の半 導体層と、第1の半導体層上に設けられた第1の電極 と、第3の半導体層上に設けられた第2の電極と、第4 の半導体層上に設けられた第3の電極とを備える面発光 サイリスタにおいて、第4の半導体層のシート抵抗値

5

を、第1の半導体層のシート抵抗値以下としたことを特 徴とする。

【0020】上記面発光ダイオードおよび面発光サイリスタにおいては、第1導電形をP形とし、第2導電形をN形とするのが好適である。

【0021】また本発明は、スイッチング動作のための しきい電圧またはしきい電流の制御電極を有するスイッ チ素子を複数個配列し、各スイッチ素子の前記制御電極 をその近傍に位置する少なくとも1つのスイッチ素子の 制御電極に、接続用抵抗または電気的に一方向性を有す る電気素子を介して接続するとともに、各スイッチ素子 の制御電極に電源ラインを負荷抵抗を介して接続し、か つ各スイッチ素子にクロックパルスラインを接続して形 成したスイッチ素子アレイと、発光動作のためのしきい 電圧またはしきい電流の制御電極を有する発光素子を複 数個配列した発光素子アレイとからなり、前記発光素子 アレイの各制御電極を前記スイッチ素子の制御電極と電 気的手段にて接続し、各発光素子に発光のための電流を 供給する配線を設けた自己走査型発光装置において、前 記発光素子およびスイッチ素子は、それぞれ、上記面発 光サイリスタよりなることを特徴とする。

【0022】また本発明の自己走査型発光装置は、前記スイッチ素子アレイと前記発光素子アレイとを、略平行に、かつ略直線状に配列し、前記各スイッチ素子の第1の電極および前記各発光素子の第1の電極を、前記スイッチ素子アレイと前記発光素子アレイとの間に設けられた共通の1本の接地配線より構成するのが好適である。

【0023】さらに本発明の自己走査型発光装置は、前記電流供給配線に接続される第1のボンディングパッドと、前記接地配線に接続される第2のボンディングパッドとを備え、前記第1および第2のボンディングパッドを、前記発光素子アレイの配列方向両端に設けるのが好適である。

【0024】また本発明の自己走査型発光装置は、発光動作のためのしきい電圧またはしきい電流の制御電極を有する発光素子を複数個配列し、各発光素子の前記制御電極をその近傍に位置する少なくとも1つの発光素子の制御電極に、接続用抵抗または電気的に一方向性を有する電気素子を介して接続するとともに、各発光素子に電源ラインを負荷抵抗を介して前記制御電極に接続し、か40つ各発光素子にクロックラインを接続して形成した自己走査型発光装置において、前記発光素子は、上記面発光サイリスタよりなることを特徴とする。

[0025]

【発明の実施の形態】

[0026]

【実施例1】図3は、図2の面発光ダイオードの改良を 説明するための図である。基本構成は図2と全く同じで ある。すなわち、絶縁GaAs基板10上にP形AlG aAs層11およびN形AlGaAs層12が設けら れ、N形層12上にカソード電極13が、P形層11上

にアノード電極14が設けられている。 【0027】本実施例の面発光ダイオードでは、N形半 導体層12およびP形半導体層11のサイズおよび不純 物濃度を調整することによって、半導体層内の横方向電 流に伴う抵抗値(シート抵抗値)を制御することによっ

て、電流の分布を変えることができる。

【0028】図3に示すように、カソード電極13直下よりアノード電極14に至るシート抵抗回路を考えた場合、N形半導体層12のシート抵抗値を R_{N} , P形半導体層11のシート抵抗値を R_{N} , R, は前述したように、N形半導体層12, P形半導体層11のサイズおよび不純物濃度で定まる。一例として、N形層12の厚さを0.5~2 μ m、不純物濃度を10 18 cm $^{-3}$ 、P形層11の厚さを0.5~2 μ m、不純物濃度を10 18 cm $^{-3}$ 、とシート抵抗値 R_{11} とシート抵抗値 R_{12} とシート抵抗値 R_{13} とシート抵抗値 R_{13} はほぼ等しくなる。その結果、カソード電極13からアノード電極14への電子の流れ、すなわちアノード電極14からカソード電極13への電流の流れは、ほぼ均等に拡がる。したがって、半導体層のシート抵抗値を調整しない場合に比べて、外部発光効率を高める(約50%)ことができた。

【0029】さらに、シート抵抗値R, をシート抵抗値R, よりも小さくすると、図4に示すように、電流が端に集中するので、さらに外部発光効率が上がる。

【0030】以上の実施例では、絶縁基板上にP形半導体層およびN形半導体層の順序で積層された構造について説明したが、N形半導体層およびP形半導体層の順序で積層された構造であってもよい。この場合、不純物濃度の設定の点からは、N形半導体のシート抵抗値をP形半導体のシート抵抗値よりも小さくすることの方が容易である。したがって、図4に示した電流分布を得るには、絶縁基板上にP形半導体層およびN形半導体層の順序で積層された構造とするのが好適である。

【0031】また、以上の実施例では、絶縁基板上に直接にPN構造を形成しているが、基板の直上の半導体層の結晶性の悪さから、デバイスとしての特性が劣化するおそれがある場合には、前記直上の半導体層と同一の導電形の半導体層を設け、この上にPN接合を形成してもよい。

【0032】以上の実施例では、ヘテロ接合構造の面発 光ダイオードについて説明したが、ダブルヘテロ構造, ホモ接合構造, 量子井戸構造を含む面発光ダイオードに も適用できる。

[0033]

50

【実施例2】図5は、本発明を面発光サイリスタに適用した例を示す図である。この実施例によれば、絶縁GaAs基板31上に、GaAsまたはAlGaAsよりなるP形半導体層32,N形半導体層33,P形半導体層34,N形半導体層35が順に積層されている。N形層

35上にカソード電極36、P形層34上にゲート電極、P形層32上にアノード電極38が設けられている。カソード電極36真下よりアノード電極38に至るシート抵抗回路を考えた場合、N形層35のシート抵抗値を $R_{\rm N}$ 、P形層32のシート抵抗値を $R_{\rm N}$ 、とすると、シート抵抗値 $R_{\rm N}$ 、R。はN形半導体層35、P形半導体層32のサイズおよび不純物濃度で定まる。一例として、N形層35の厚さを0.5~2 μ m、不純物濃度を10 18 cm $^{-3}$ 、P形層32の厚さを0.5~2 μ m、不純物濃度を10 18 cm $^{-3}$ 、P形層32の厚さを0.5~2 μ m、不純物濃度を10 18 cm $^{-3}$ 、とすると、シート抵抗値 $R_{\rm N}$ はシート抵抗値 $R_{\rm N}$ よりも小さくなる。その結果、図6に示すように電流が端に集中するので、外部発光効率が上がる。

【0034】以上の実施例は、絶縁基板上に、順にP形,N形,P形,N形の半導体層を積層した面発光サイリスタを説明したが、絶縁基板上に、順にN形,P形,N形,P形の半導体層を積層した面発光サイリスタとすることもできる。但し、不純物濃度の設定の点からは、前者の方が製造が容易である。

【0035】また、以上の実施例では、絶縁基板上に直接にPNPN構造を形成しているが、基板の直上の半導体層の結晶性の悪さから、デバイスとしての特性が劣化するおそれがある場合には、前記直上の半導体層と同一の導電形の半導体層を設け、この上にPNPN構造を形成してもよい。

[0036]

【実施例3】実施例2の面発光サイリスタを用いた自己走査型発光装置について説明する。図7に、この自己走査型発光装置の等価回路図を示す。この自己走査型発光装置は、シフトレジスタを構成するスイッチ素子アレイT(-1)~T(2)、書き込み用発光素子アレイL(-1)~L(2)からなる。隣接するスイッチ素子のゲート電極間は、ダイオード D_{-1} , D_{0} , D_{1} を用いて接続している。スイッチ素子の各アノード電極は交互に転送クロックライン ϕ_{1} , ϕ_{2} に接続されている。スイッチ素子のゲート電極 G_{-1} ~ G_{1} は、負荷抵抗 R_{L} を介して電源電圧 V_{α} に接続されるとともに、書き込み用発光素子のゲートにも接続される。書き込み用発光素子のアノード電極には、書き込み信号 S_{1n} が加えられている。初段のスイッチ素子のゲート電極には、スタートパルス ϕ_{5} が印加され、スイッチ素子がオン状態にされる。

【0037】スイッチ素子および発光素子には、本発明の面発光サイリスタを用いる。いま、スイッチ素子T(0)がオン状態にあるとすると、ゲート電極G。の電圧は、電源電圧 V_{α} (ここでは5ボルトとする)より低下し、ほぼ零ボルトとなる。したがって、書き込み信号 S_{in} の電圧が、PN接合の拡散電位(約1ボルト)以上であれば、発光素子L(0)の発光状態とすることができる。

8

【0038】これに対し、ゲート電極 G_{-1} は約5ボルトであり、ゲート電極 G_{1} は約1ボルト(ダイオード D_{0} の順方向立上り電圧)となる。したがって、発光素子レ(-1)の書き込み電圧は約6ボルト、発光素子レ(1)の書き込み電圧は約2ボルトとなる。これから、発光素子L(0)のみに書き込める書き込み信号 S_{10} の

発光素子L(0)のみに書き込める書き込み信号Sinの電圧は、1~2ボルトの範囲となる。発光素子L(0)がオン、すなわち発光状態に入ると、書き込み信号Sinラインの電圧は約1ボルトに固定されてしまうので、他の発光素子が選択されてしまう、というエラーは防ぐことができる。

【0039】発光強度は書き込み信号S_{in}に流す電流量で決められ、任意の強度にて画像書き込みが可能となる。また、発光状態を次の発光素子に転送するためには、書き込み信号S_{in}ラインの電圧を一度零ポルトまでおとし、発光している発光素子をいったんオフにしておく必要がある。

【0040】図8は、1つの発光素子Lと、この発光素子に接続されるスイッチ素子TおよびダイオードDの簡略化した構成断面図を示す。絶縁GaAs基板20上にN形半導体層24が積層されている。発光素子Lは、N形半導体層24と、この上に島状に積層されたP形半導体層23、N形半導体層22、P形半導体層21により形成される。P形半導体層21上にはアノード電極26が設けられ、N形半導体層22上にはゲート電極27が設けられている。

【0041】一方、スイッチ素子TおよびダイオードDは、N形半導体層24と、この上に島状に積層されたP形半導体層23,N形半導体層22,P形半導体層21 a,21 bにより形成される。半導体層21 aと21 bとは層22上で2つの島に分離されており、半導体層21 aはスイッチ素子の一部を、半導体層21 bはダイオードの一部を構成する。半導体層21 a上にはアノード電極28が設けられ、半導体層22上には、半導体層21 a,21 bを挟むようにして2つのゲート電極29 a,29 bが設けられている。これら2つのゲート電極は、下側の半導体層22を介して電気的に接続されている。

【0042】スイッチ素子アレイと発光素子アレイとの間には、ストライプ状のグランド(GND)電極41が設けられている。このGND電極は、スイッチ素子Tおよび発光素子Lの共通のカソード電極となる。GND電極の材料は、下側半導体層24がN形であるので、オーミック接触するAuGeNiとするのが好適である。また、下側半導体層がP形の場合には、AuZnとするのが好適である。

【0043】スイッチ素子Tの一方のゲート電極29bは、負荷抵抗R」を介して電源電圧Vαに接続され、ダイオードDのアノード層21bは次段のゲート電極29bに接続される。スイッチ素子Tのアノード電極28

己走査型発光装置の他の例を示す。本実施例は、複数の 発光素子を同時に発光できるようにした発光装置であ る。この自己走査型発光装置の等価回路図を、図11に 示す。

10

は、転送のロックラインφ」またはφ2に接続される。スイッチ素子Tの他方のゲート電極29aは、配線42により発光素子Lのゲート電極27に接続される。発光素子Lのアノード電極26は、書き込み信号Simに接続される。

【0050】図7の回路と異なるのは、発光素子を3つずつのブロックとし、1ブロック内の発光素子は1つのスイッチ素子によって制御し、かつ1ブロック内の発光素子にそれぞれ別々の書き込み信号ライン S_{in} 1, S_{in} 2, S_{in} 3を接続して、発光素子の発光を制御した点である。図中、発光素子 L_{in} 1, L_{in} 2, L_{in} 1, L_{in} 2, L_{in} 3, L_{in} 4, L_{in} 5, L_{in} 6, L_{in} 7, L_{in} 7, L_{in} 8, L_{in} 9, L_{in}

【0044】図9は、図7の自己走査型発光装置が形成されたチップの概略を示す平面図である。図中、43はGND取出しパッドであり、44はSin信号取出しパッドである。GND取出しパッド43はGND配線41に接続され、Sin信号取出しパッド44は配線45を介して、各発光素子のアノード電極26に接続されている。なお、図7と同一の要素には同一の参照番号を付して示してある。

【0051】動作は図7の回路と同じで、1素子ずつSinによって発光が書き込まれていたものが、同時に複数書き込まれ発光し、それがブロックごとに転送するようになったものである。

【0045】GND配線41を、スイッチ素子アレイと 発光素子アレイとの間に設けるのは、以下の理由によ る。図8からもわかるように、スイッチ素子Tと発光素 子LとはGaAs基板1およびN形半導体層24を介し て電気的に接続されている。したがって、発光素子また はスイッチ素子の電位変動が相互に影響しないようにす るためである。

【0052】いま、LEDプリンタ等の一般的に知られる光プリンタ用の光源として、この発光装置を用いることを考えると、A4の短辺(約21cm)相当のプリントを16ドット/mmの解像度で印字するためには約3400ビットの発光素子が必要になる。

【0046】図7~図9に示した自己走査型発光装置では、絶縁基板20上に、順にN形、P形、N形、P形の半導体層を積層した構造を用いているが、基板の導電形をP形とし、P形基板上に、順にP形、N形、P形、N形の半導体層を積層した構造を用いることもできる。前述したように、スイッチ素子Tおよび発光素子Lに本発明の面発光サイリスタを使用する場合には、不純物濃度の設定の点からは、後者の方が好適である。

【0053】実施例1にて説明してきた発光装置では、発光しているポイントは常に一つで、上記の場合ではこの発光の強度を変化させて画像を書き込むことになる。これを用いて光プリンタを形成すると、通常使用されている光プリンタ用LEDアレイ(これは画像を書き込むポイントに位置するLEDが、同時に発光するよう駆動ICによって制御されている)に比べ、画像書き込み時に3400倍の輝度が必要となり、発光効率が同じならば3400倍の電流を流す必要がある。ただし発光時間は、逆に通常のLEDアレイに比べ1/3400となる

【0047】また、図9に示したように、GND取出しパッド43およびSin信号取出しパッド44は、チップの左右両端にそれぞれ設けられている。左右両端に設けるのは、以下の理由による。すなわち、GND配線41およびSin信号配線45には、配線抵抗が存在する。図10に発光素子アレイに対するGND配線41およびSin信号配線45の配線抵抗分布を示す。Rom はGND配線の分布抵抗を、RinはSin信号配線の分布抵抗を示す。

【0054】しかし発光素子は、一般的に電流が増えると加速度的に寿命が短くなる傾向があり、いくらデューティが1/3400とはいえ従来のLEDプリンタに比べ、寿命が短くなってしまうという問題点を持っていた

【0048】前述したように自己走査型発光装置では、発光サイリスタは自己走査により発光点が順次移動していく。発光している1つのサイリスタに注目した場合、電流はS_{in}信号パッド43から発光サイリスタのアノード電極、カソード電極を経て、GNDパッド43に流れる。この電流経路中の配線抵抗の総和は、どのサイリスタが発光していても同じである。したがって、発光するサイリスタに流れる電流は等しくなる。発光サイリスタの発光量は、流れる電流により決まるから、全発光サイリスタを通じて均一の光を発することができ、発光ムラが生じないという利点がある。

40 【0055】しかしながら本実施例によると、ビット総数が同じ条件で比較すると、この例では1ブロックに3素子が入っているため、実施例3の発光装置に比べて1素子の発光時間は3倍となる。したがって、オン状態の発光素子に流す電流は1/3でよく、実施例3に比べ長寿命化することが可能である。

[0049]

【0056】本実施例では、1ブロックに3素子が含まれる場合を例示したが、この素子数が大きいほうが書き込み電流が小さくて済み、さらに長寿命化をはかることができる。

【実施例4】本発明の面発光サイリスタを適用できる自

[0057]

【実施例5】本実施例は、特開平4-23367号公報 に示された自己走査型発光装置であって、本発明の面発 光サイリスタを適用できる1つの例である。

【0058】実施例の発光装置を図12に示す。図12 においては、スイッチ素子アレイと発光素子アレイと が、上下に分けて記載されている。

【0059】まず、シフトレジスタ機能を有するスイッチ素子アレイについて説明する。 $S(-2)\sim S(2)$ は、スイッチ素子(PNPN構造を有するサイリスタ)である。 ϕ_1 , ϕ_2 は、スイッチ素子アレイを駆動する転送クロックである。そして、 CL_1 は転送クロック ϕ_1 を供給されるクロックラインであり、 CL_2 は転送クロック ϕ_2 を供給されるクロックラインである。

【0060】各スイッチ素子S(-2)~S(2)のゲート電極 G_{-1} ~ G_2 の間は、それぞれ結合用ダイオード D_{-2} ~ D_1 によって、接続されている。このようなダイオード結合方式を採用しているために、スイッチ素子アレイは 2 相の転送クロック ϕ_1 , ϕ_2 にて情報の転送動作を行うことができる。

【0061】また、 R_{AI} , R_{A2} は、それぞれ各スイッチ素子S(-2)~S(2)のアノードとクロックラインCL₁, CL₂のいずれか一方とを接続するアノード負荷抵抗である。このアノード負荷抵抗 R_{AI} , R_{A2} は、各スイッチ素子S(-2)~S(2)のオン状態での電流量を制限するものである。各スイッチ素子S(-2)~S(2)のカソードはそれぞれ接地されている。【0062】さらに、 R_{LI} , R_{L2} は、それぞれ各スイッチ素子S(-2)~S(2)のゲート G_{-2} ~ G_{2} と電源電圧 V_{CR} の直流電源とを接続するゲートの負荷抵抗である。このゲート負荷抵抗 R_{L1} , R_{L2} は、電源電圧 V_{CR} の直流電源から各ゲート G_{-2} ~ G_{2} に流れる電流量を制限するものである。そして、各ゲート G_{-2} 、 G_{0} , G_{2} は、それぞれダイオード D_{-2} ′, D_{0} ′, D_{2} ′ のカソードに接続されている。

【0063】次に、発光素子アレイについて説明する。 ϕ_R は発光素子(発光サイリスタ) L (-2), L (0), L (2) への情報の書き込み許可/禁止を制御し、かつ書き込まれた状態をリセットするクロックである。そして、 CL_R はクロック ϕ_R を供給する電流供給ラインである。

【0064】また R_{ss} は、各発光素子L(-2), L(0), L(2) のアノードと電流供給ライン CL_{s} とを接続するアノード負荷抵抗である。このアノード負荷抵抗 R_{ss} は、各発光素子L(-2), L(0), L(2) のオン状態での電流量を制限するものである。そして、各発光素子L(-2), L(0), L(2) のカソードは、それぞれ接地されている。

【0065】さらに R_{13} は、各発光素子L(-2), L(0), L(2) のゲート G_{-2} ′, G_{0} ′, G_{2} ′ と電源電圧 V_{cc} とを接続するゲート負荷抵抗である。このゲ

12

ート負荷抵抗 R_{13} は、電源電圧 V_{cx} の直流電源から、各ゲート G_{-2}^{\prime} , G_{0}^{\prime} , G_{2}^{\prime} に流れる電流量を制限するものである。そして、各ゲート G_{-2}^{\prime} , G_{0}^{\prime} , G_{2}^{\prime} は、それぞれダイオード D_{-2}^{\prime} , D_{0}^{\prime} , D_{2}^{\prime} のアノードに接続されている。

【0066】すなわち、図12においては、スイッチ素子S(-2),S(0),S(2)のゲートが、それぞれダイオード D_2 ′, D_0 ′, D_2 ′を介して、発光素子L(-2),L(0),L(2)のゲート G_2 ′,G10。′, G_2 ′に個々に接続されている。

【0067】次に、スイッチ素子アレイの部分の動作を説明する。今、スタートパルス ϕ_s として、ハイレベルまたはローレベルの電圧がスイッチ素子S(-3)のアノード(図示せず)に供給されたとする。この場合に、ハイレベルの電圧が、電源電圧 $V_{\alpha t}$ に拡散電位 $V_{\alpha t}$ を加えた電圧以上に高ければ、スイッチ素子S(-3)はオン状態になる。そして、次に供給されるスタートパルス ϕ_s のローレベルの電圧が、スイッチ素子S(-3)のオン状態維持電圧より低ければ、S(-3)はオフ状20態となる。

【0068】オン状態では、スイッチ素子S(-3)の ゲート電位はほぼ零ボルトとなり、オフ状態ではゲート電圧は電源電圧 V_{α} と同じ電圧になる。スイッチ素子S(-3)のゲート電位が零ボルトになれば、結合用ダイオード D_{α} (図示せず)によって、スイッチ素子S(-2)のゲート電位が低下する。そして、スイッチ素子S(-2)のターンオン電圧も低下する。したがって、転送クロック ϕ_2 によって、スイッチ素子S(-2)をオン状態に設定することができる。

30 【0069】このオン状態はφ1, φ2によって順次、 図12の右方向へ転送されていく。つまり、スタートパルスφ5のハイレベルの電圧によって、スイッチ素子アレイにオン状態が書き込まれ、それが順次右方向へ転送されていくことになる。

【0070】ただし、全てのビットがオン状態にある場合に、このオン状態を転送することは、このスイッチ素子アレイの動作原理上から不可能であって、1ビットおきにオンとオフを繰り返して転送することになる。すなわち、スタートパルスφsの波形も、転送パルスφ1, φ。に同期して、ハイレベルとローレベルとを交互に送

0 φ₂に同期して、ハイレベルとローレベルとを交互に送る必要がある。

【0071】今、偶数ビットのみのオン状態とオフ状態に有効な情報があるものとして、オン状態を1、オフ状態を0とすると、スタートパルス ϕ_s によって1または0が書き込まれ、転送クロック ϕ_1 , ϕ_2 によって、その1, 0が転送されて行くことになる。このようにして、1または0という信号(情報)がスイッチ素子アレイに書き込まれる。

【0072】次に、発光素子L(-2)(L(0), L(2))の動作について説明する。仮に、L(-2)が

0であるとすると、クロック ϕ_R の電圧が零ボルトであれば、発光素子L(-2)はオン状態とはならない。すなわち、発光素子L(-2)は書き込み禁止の状態に設定される。クロック ϕ_R の電圧が、発光素子L(-2)のオン状態維持電圧から $V_{GC}+V_{GI}$ の間の電圧に設定されたとすると、発光素子L(-2)は書き込み許可の状態に設定される。そして、ゲート G_2 1′の電位が変化させられることによって、発光素子L(-2)はオン状態に設定可能となる。

【0073】さて、スイッチ素子アレイから発光素子アレイへの情報の書き込みについて説明する。スイッチ素子アレイは、前述したように1または0信号が書き込まれる。最後のビットまで書き込まれた段階で、転送クロックφ1, φ2をそれぞれローレベル,ハイレベルの状態に維持される。これによって、情報の転送動作が終了し、スイッチ素子アレイに書き込まれた情報は保持される(特に、偶数ビットにおいて保持されている)。

【0074】スイッチ素子アレイの偶数ビットにおいて、オン状態のスイッチ素子Sのゲート電位はほぼ零ボルトであり、オフ状態のスイッチ素子Sのゲート電位は、Vair の約2倍以上である。なお、オフ状態のスイッチ素子Sのゲート電位については、転送方向に対して逆方向に位置する最も隣接する偶数ビットがオン状態の場合にVair の約2倍であり、それ以外はVair の約2倍の電圧よりも大きくなる。なお、ここでVair はPN接合の拡散電位である。

【0075】スイッチ素子S(-2), S(0), S(2) のそれぞれのゲート電圧は、ダイオード D_2 , D_6 , D_2 , によって対応する発光素子L(-2), L(0), L(2) のゲート G_2 , G_6 , G_2 , に伝達される。したがって、発光素子L(-2), L(0), L(2) のゲート電圧は、オン状態の場合で $V_{\rm dif}$ の3倍以上となる。そしてオン状態の場合で、発光素子のターンオン電圧は $V_{\rm dif}$ の2倍となり、オフ状態で $V_{\rm dif}$ の4倍となる。

【0076】一方、クロック ϕ_R については、いったん 零ボルトに設定して全体の発光をなくし(すなわち、リセット)、その後にハイレベル電位 V_R まで上昇させる。この電圧 ϕ_R として

 $2\;V_{\text{\tiny dif}}\;<\!V_{\text{\tiny HR}}\!<\!4\;V_{\text{\tiny dif}}$

の範囲に設定されていると、オン状態のスイッチ素子Sに対応する発光素子Lがオン状態となり、オフ状態のスイッチ素子Sの対応する発光素子Lはオフ状態のままになる。

【0077】したがって、スイッチ素子アレイに書き込まれた1,0の情報が、そのまま発光素子アレイに書き込まれることになる。

【0078】この後、電圧Viriは発光素子のオン状態維持電圧以上であってViriの2倍の電圧未満の値に再設

14

定される。このことにより、発光素子 L は、スイッチ素子 S のゲート電位に影響されなくなり、書き込まれた情報を保持し続ける。そして、発光素子アレイが情報の保持状態にある間に、前述と同様にして、スイッチ素子アレイには次の情報が書き込まれる。

【0079】やがて、クロックφ_kがローレベル電圧に 設定されて、各発光素子Lがリセットされる。リセット 後、再び情報が発光素子アレイに書き込まれる。以上の ようにして、一連の動作が繰り返し行われる。

10 【0080】次に図12に示す発光装置を、光プリンタ 用の書き込み光源に適用した場合について述べる。

【0081】例えば、発光装置が2048ビットの発光素子Lを有するものとすると、スイッチ素子Sはその倍の4096ビットを必要とする。光プリンタにおける書き込み光源の電流量は約5mAであるから、全てのビットの発光素子Lが発光状態であるとすると、約10Aという電流が流れる。

【0082】一方、スイッチ素子Sからの情報転送のための電流は、ゲート負荷抵抗 R_{μ} = $30k\Omega$ の場合に0.5mAであることが実験的にわかっているので、全てのビットの発光素子が発光状態であれば、1A程度である。なお、この情報転送のための電流量は、光プリンティングに必要な10Aに比べ1割程度であり、実用上間題のない値である。

【0083】また、スイッチ素子Sからの情報が、発光素子Lに移動させられた段階でクロックφ1, φ2の電圧を一旦零ボルトに低下させることにより、スイッチ素子アレイ全体がオフ状態となりリセットが行われる。この方法を用いた場合には、スイッチ素子Sがオン状態になる時間が考慮されると、等価的に電流値が下がることとなる。つまり、前述の1Aに比べて等価的に0.5A程度まで下がったことになる。

【0084】発光素子Lの2048ビットに対して、スタートパルスφ。が供給されるデータ入力端(図示せず)が1つだけでは、情報の転送速度はかなり高速であることが必要である。この点については、データ入力端を複数設けることによって、情報の転送速度を低下させることができる。例えば、通常64ビットまたは128ビットを一単位として発光素子Lのチップが形成され、このチップごとに情報が入力されてもよい。

【0085】128ビットごとにデータ入力を並列に行った場合、2048ビットに対して20個のデータ入力端を有することになる。このため、情報の転送速度は1/20でよいことになる。したがって、発光装置は余裕のある動作を行うことができる。

【0086】なお、発光素子Lの出力光の光量のばらつきを防ぐために、アノード負荷抵抗Rusをレーザ等により微調整することが可能である。このことによって、出力光のばらつきのない発光装置を得ることができる。

【0087】また、図12では、スイッチ素子アレイに

50

おける偶数ビットの右側に接続される結合用ダイオード D-2, D。の特性と、奇数ビットの右側に接続される結 合用ダイオードD-1, D1 の特性とが異なっている。し たがって、偶数ビットと奇数ビットとで動作電流等を分 けて最適化することが重要である。このために、Ruc Ru、Ru<Ruに設定するほうが望ましく、この場合 には発光装置はより安定で高速な動作を行い得る。

【0088】さらに、図12では、ダイオード結合方式 と呼ばれる構成を採用しているが、結合方式はこれに限 られず、抵抗結合方式であってもよい。

[0089]

【実施例6】図13は、本発明の面発光サイリスタを適 用できる自己走査型発光装置の他の例を示す図である。 この自己走査型発光装置は、実施例3の自己走査型発光 装置とは異なり、シフトレジスタを有していない。発光 素子として、面発光サイリスタT(-2)~T(+2)を用い、面発光サイリスタT (-2)~T (+2)に は、各々ゲート電極G-2~G-2が設けられている。各々 * $V_{co} < V_{c_1} = V_{c_{-1}} < V_{c_2} = V_{c_{-2}}$

これらの電圧の差は、負荷抵抗R」、結合用抵抗R」の 値を適当に選択することにより設定することができる。 【0092】3端子サイリスタのアノード側のターンオ

ン電圧Vωは、ゲート電圧よりPN接合の拡散電位V dif だけ高い電圧となることが知られている。

$$[0\ 0\ 9\ 3]\ V_{ox} = V_{c} + V_{dif}$$
 (2)

したがって、アノードにかける電圧をこのターンオン電 圧Voxより高く設定すれば、その発光サイリスタはオン することになる。

【0094】さてこの面発光サイリスタT(0)がオン している状態で、次の転送クロックパルスも、にハイレ ベル電圧V』を印加する。このクロックパルスφ」は面 発光サイリスタT (+1) とT (-2) に同時に加わる が、ハイレベル電圧V。の値を次の範囲に設定すると、 面発光サイリスタT (+1) のみをオンさせることがで きる。

[0095]

 $V_{\text{G-}2} + V_{\text{dif}} > V_{\text{H}} > V_{\text{G+}1} + V_{\text{dif}}$ (3) これで面発光サイリスタT(0), T(+1)が同時に オンしていることになる。そしてクロックパルス ø 。の ハイレベル電圧を切ると、面発光サイリスタT(0)が オフとなりオン状態の転送ができたことになる。

【0096】このように、本実施例では抵抗ネットワー クで各面発光サイリスタのゲート電極間を結ぶことによ り、面発光サイリスタに転送機能をもたせることが可能 となる。

【0097】上に述べたような原理から、転送クロック φ1, φ2, φ, のハイレベル電圧を順番に互いに少し ずつ重なるように設定すれば、発光サイリスタのオン状 態は順次転送されていく。すなわち、発光点が順次転送 され、自己走査型発光装置を実現することができる。

*のゲート電極には、負荷抵抗R」を介して電源電圧Vax が印加される。また、各々のゲート電極 G-2~ G-2は、 相互作用を作るために結合用抵抗R」を介して電気的に 接続されている。また、各単体発光サイリスタのアノー ド電極に、3本の転送クロックライン (φ1, φ2, φ ,)が、それぞれ3素子おきに(繰り返されるように) 接続される。

16

【0090】動作を説明すると、まず転送クロックφ、 がハイレベルになり、面発光サイリスタT(0)がオン しているとする。このとき3端子サイリスタの特性か ら、ゲート電極G。は零ボルト近くまで引き下げられ る。電源電圧Vaを仮に5ボルトとすると、負荷抵抗R ι、結合用抵抗 R₁のネットワークから各面発光サイリ スタのゲート電圧が決まる。そして、面発光サイリスタ T(0)に近い素子のゲート電圧が最も低下し、以降順 にT(0)から離れるにしたがいゲート電圧は上昇して いく。これは次のように表せる。

[0091]

(1)

[0098]

【実施例7】図14は、実施例6において結合用抵抗に 代えて、ダイオードを用いた自己走査型発光装置を示す 図である。

【0099】本実施例の自己走査型発光装置では、面発 光サイリスタT (-2) ~T (+2は、一列に並べられ た構成となっている。G-2~G-2は、面発光サイリスタ T (-2) ~T (+2) のそれぞれのゲート電極を表 す。R、はゲート電極の負荷抵抗を表し、D-2~D+2は 電気的相互作用を行うダイオードを表す。またVαは電 源電圧を表す。各単体面発光サイリスタのアノード電極 に、2本の転送クロックライン (φ1, φ2) がそれぞ れ1素子おきに接続される。

【0100】動作を説明する。まず転送クロック φ₂ が ハイレベルとなり、面発光サイリスタT(0)がオンし ているとする。このとき3端子サイリスタの特性からゲ ート電極G。は零ボルト近くまで引き下げられる。電源 電圧Vaを仮に5ボルトとすると、抵抗R₁,ダイオー ドD-2~D+2のネットワークから各発光サイリスタのゲ ート電圧が決まる。そして発光サイリスタT (0) に近 い素子のゲート電圧が最も低下し、以降順にT(O)か ら離れるにしたがいゲート電圧は上昇していく。

【0101】しかしながら、ダイオード特性の一方向 性,非対称性から、電圧を下げる効果は、T(0)の右 方向にしか働かない。すなわちゲート電極G」はG。に 対し、ダイオードの順方向立ち上がり電圧Voit (PN 接合の拡散電位に等しい) だけ高い電圧に設定され、ゲ ート電極G。はG, に対し、さらにダイオードの順方向 立ち上がり電圧Viii だけ高い電圧に設定される。一 方、T(0)の左側のゲート電極G-」はダイオードD-1 50 が逆バイアスになっているため電流が流れず、したがっ

40



て電源電圧Vacと同電位となる。

【0102】次の転送クロックパルス ϕ_1 は、最近接の発光サイリスタT (1) , T (-1) 、そしてT (3) およびT (-3) 等に印加されるが、これらのなかで、最もターンオン電圧の最も低い素子はT (1) であり、T (1) のターンオン電圧は約 G_1 のゲート電圧+V であるが、これは V_{tit} の約2倍である。次にターン電圧の低い素子はT (3) であり、 V_{tit} の約4倍である。T (-1) とT (-3) のオン電圧は、約 $V_{\alpha t}$ となる。

【0103】以上から、転送クロックパルスのハイレベル電圧を $V_{\rm dif}$ の約2倍から $V_{\rm dif}$ の約4倍の間に設定しておけば、発光サイリスタT(1)のみをオンさせることができ、転送動作を行うことができる。

[0104]

【実施例8】本発明の自己走査型発光装置の応用例とし て光プリンタへの応用について述べる。従来、LEDア レイの各画素に駆動用ICを接続したモジュールを使っ て光プリンタへ応用した例が知られている。光プリンタ の原理図を図15に示す。まず円筒形の感光ドラム61 の表面にアモルファスSi等の光導伝性を持つ材料(感 光体)が作られている。このドラムはプリントの速度で 回転している。まず帯電器67で感光体表面を一様に帯 電させる。そして発光素子アレイ光プリントヘッド68 で印字するドットイメージの光を感光体上に照射し、光 の当たったところの帯電を中和する。次に現像器で感光 体上の帯電状態に従って、トナーを感光体上に付ける。 そして転写器62でカセット611中から送られてきた 用紙69上にトナーを転写する。そしてその用紙は定着 器63にて熱等を加えられ定着される。一方転写の終了 したドラムは消去ランプ65で帯電が全面に渡って中和 され、清掃器66で残ったトナーが除去される。

【0105】さて本発明による自己走査型発光装置を所定の実装基板上に直線状に一列に配列した発光素子アレイモジュールを光プリントヘッドに応用する。光プリントヘッドの構造を図16に示す。この光プリントヘッドは、発光素子アレイ612とロッドレンズアレイ613とで構成され、レンズの焦点が感光ドラム61上に結ぶようになっている。この発光素子アレイモジュールからの光で感光ドラムに画像情報を書き込むことができる。【0106】本実施例によれば、この発光素子アレイモ

【0106】本実施例によれば、この発光素子アレイモジュールのコストを従来よりはるかに低減できるため、 低価格のプリントヘッド、低価格の光プリンタを提供することができる。

[0107]

【発明の効果】本発明によれば、外部発光効率の良い面 発光素子を提供することが可能であり、このような面発 光素子のうち面発光サイリスタを用いた自己走査型発光* * 装置は、外部発光効率が良い。さらには、このような自己走査型発光装置を用いて、光プリンタ用の低価格の光プリントヘッドを実現することができる。

18

【図面の簡単な説明】

【図1】メサ型のPNPN構造の従来の面発光サイリスタの断面図および平面図である。

【図2】従来の面発光ダイオードの断面図である。

【図3】本発明の面発光ダイオードの改良を説明するための図である。

10 【図4】図3の面発光ダイオードの電流分布を示す図で ある。

【図5】本発明の面発光サイリスタを示す図である。

【図 6 】図 5 の面発光サイリスタの電流分布を示す図である。

【図7】自己走査型発光装置の等価回路図である。

【図8】自己走査型発光装置における、1 つの発光素子 Lと、この発光素子に接続されるスイッチ素子Tおよび ダイオードDの簡略化した構成断面図である。

【図9】図7の自己走査型発光装置が形成されたチップ の概略を示す平面図である。

【図10】発光素子アレイに対するGND配線およびSin信号配線の配線抵抗分布を示す図である。

【図11】他の自己走査型発光装置の等価回路図である。

【図12】他の自己走査型発光装置の等価回路図である。

【図13】他の自己走査型発光装置の等価回路図である。

【図14】他の自己走査型発光装置の等価回路図であ 30 る。

【図15】光プリンタ装置を示す図である。

【図16】発光素子モジュールとロッドレンズアレイと の組合せを示す図である。

【符号の説明】

T スイッチ素子

L 発光素子

φ1, φ2 転送用クロックパルス

Va 電源電圧

φ s スタートパルス

40 S_{in} 書き込み信号

1 N形基板

10, 20, 31 絶縁基板

13 カソード電極

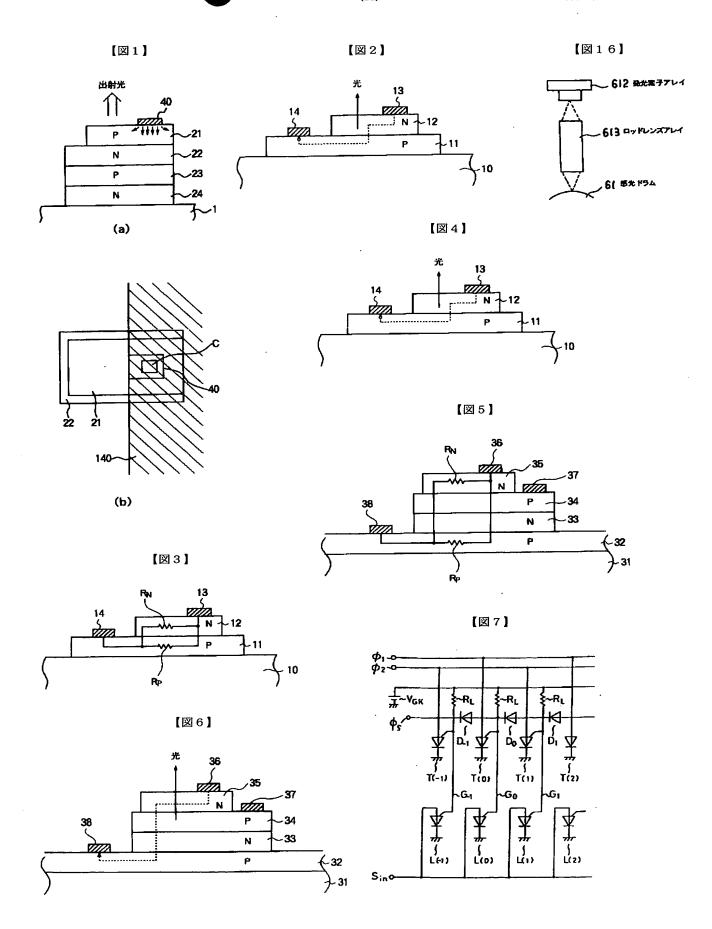
14,26 アノード電極

11, 22, 24, 32, 34 P形半導体層

12, 21, 23, 33, 35 N形半導体層

38 アノード電極

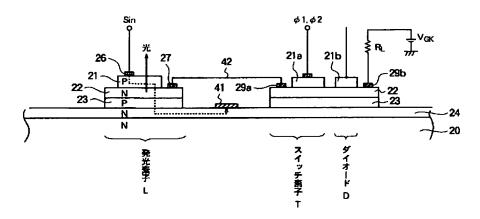
41 GND配線



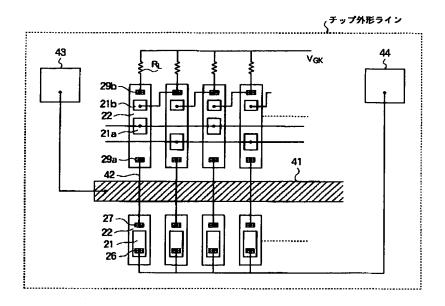




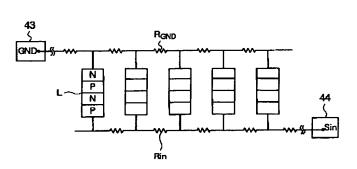
【図8】



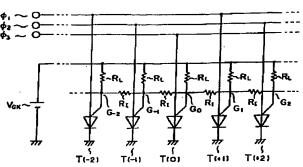
[図9]



【図10】

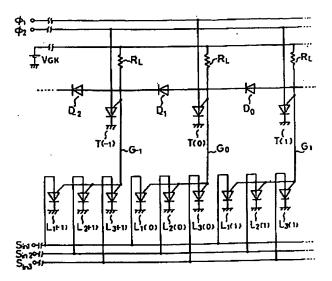


【図13】

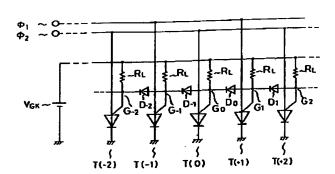




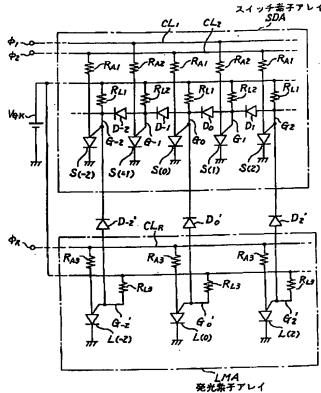
【図11】



【図14】



【図12】



【図15】

